附件

人工智能技术需求征集表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业简介（基本信息、主要产品 |  | | |
| 技术需求名称 | *示例：高性能云端人工智能芯片* | | |
| 所属方向 | □智能芯片□智能传感器□AI算法和框架□智慧交通□智能识别系统□智慧物流□智能医疗装备□智能机器人□智能制造关键装备□智能教育产品□智能安防□AI安全与治理□人工智能开放平台 □其他 | | |
| 需求任务的简要说明 | （概述需求内容，包括具体技术产品攻关任务，需突破的技术短板、创新点，解决的关键技术问题等。限500字）  *示例：研制高性能云端人工智能芯片，突破适用于人工智能计算范式的矩阵乘加内核架构、新一代高带宽内存、内存原子操作、高速互联总线、协处理机制和超大芯片封装等核心技术，满足混合云环境中的低能耗训练和推理。* | | |
| 目前现状及采取的主要措施 |  | | |
| 指标建议 | （明确提出1-2年的预期目标及参数指标，且应领先于当前国内技术产品性能功能水平。限200字）  *示例：到2022年，训练芯片达到500TFlops/s（半精度浮点），推理芯片达到300T ops/s（INT8），能效比超2TFLOPS/w；可支持各类深度学习和经典机器学习算法，在自动驾驶、智能医疗装备、智能家居、智能终端等重点领域实现规模化商用。* | | |
| 必要性及预期成果 | （简述需求任务的重要性、必要性和紧迫性，预期成果，以及主要经济、社会效益。限500字内） | | |
| 研发投入预测 | 研发总预算 万元。 | | |
| 意向合作方式 | □技术转让 □合作技术开发 □合作创办企业 □其它 | | |
| 技术需求是否 | □需要保密 □不需要保密 | | |
| 评测方法建议 | 对所提指标参数进行评测的方法依据，如依据标准或者测试方法等的建议。 | | |
| 其他需求和建议 |  | | |